

合肥新汇成微电子股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于2025年3月制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025年度，公司按照该行动方案积极开展各项工作，在提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。为了在2026年持续巩固现有发展成果，并推动经营绩效与治理水平进一步提升，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。本行动方案旨在复盘2025年相关举措的实施成效，同时规划下一阶段关键行动，聚焦业务版图拓展、综合竞争力提升、投资者权益保障及资本市场品牌形象塑造等方面，确保公司高质量可持续发展。具体情况如下：

一、聚焦经营主业，深耕先进封装

公司自成立至今专注于集成电路先进封装测试业务，所封测芯片类型主要聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动

芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

2025年度，公司可转债募投项目顺利实施，新扩产能逐步释放，客户订单持续增加，出货量稳步提升，带动营收同比增长18.79%，达178,313.55万元；经营活动产生的现金流量净额同比增长38.25%，达69,245.88万元。报告期内，公司毛利率保持稳定，营收增长直接推动毛利额同步增加，为业绩增长提供了核心支撑。此外，报告期内公司通过对鑫丰科技进行战略投资及与华东科技建立战略合作关系的方式布局DRAM封测业务。

2026年，围绕公司发展战略，我们将继续紧抓品质和管理，提质降本增效筑牢显示驱动芯片封测领域竞争优势，同时提升产业链资源整合能力，以市场为导向、技术为支撑大力拓展产品线，丰富产品结构，为客户提供更全面、更优质的先进封装服务。

1、优化产品组合，加快智能制造升级，巩固显示驱动芯片封测领先优势

公司将依托在显示驱动芯片封测领域全流程统包生产优势，持续优化产品组合，推进车载显示芯片封装测试产能建设和大尺寸显示驱动芯片COF制程产能扩充，合理配置CP测试机和FT测试机产能，提升大尺寸显示驱动芯片及OLED显示驱动芯片等高阶产品封测业务收入占比。此外，公司还将加快智能制造系统升级，以构建自动化、智能化无人工厂为核心目标，完善智

能生产、智能物流、智能管控信息化系统，全方位保障高品质、高效率的封装测试交付，提升运营效率。

2、积极拓展前沿先进封装业务，打造新的业务增长极

公司所掌握的凸块制造工艺是实现众多先进封装工艺的关键技术，目前公司正在将凸块制造工艺由显示驱动芯片封测领域向其他高性能芯片封测领域延展，不断拓宽技术边界，积极布局前沿先进封装技术。公司将进一步加大技术研发和自主创新的力度，购置研发设备、扩大研发团队、紧跟人工智能时代市场需求，推进先进封装前沿技术的研发及产业化，打造新的业务增长极。

3、深化存储芯片封测领域布局，助力鑫丰科技产能建设和市场拓展

当前全球存储芯片市场因AI基建需求迎来结构性机遇，3D DRAM等先进存储产品需求爆发。公司通过战略投资鑫丰科技布局DRAM封测领域，后续公司将协同地方国有投资平台及其他产业合作伙伴，持续对鑫丰科技追加投资，助力其于2027年内DRAM封装产能提升至6万片/月，使其充分受益于存储芯片龙头厂商产能扩张对产业链上下游厂商的带动效应，并同步拓展定制化DRAM解决方案及3D DRAM先进封装业务，进一步打开市场空间。

4、落实人力资本战略，引进和留住核心人才

2026年公司将持续深化人力资本战略，启动全球化高端人

才引进计划，优化人才结构，引进优秀的研发人才，打造一支具备国际视野、专业能力突出的核心团队，提升组织效能，为公司战略落地提供人才保障。

同时，完善人才培养体系，提升员工专业能力与国际视野，推动人才成长与公司发展同频共振。深化长效激励计划，优化激励结构，将技术突破、市场拓展、产能提升及公司市值增长等战略指标与激励对象收益深度绑定，确保激励资源向价值创造者倾斜，强化核心团队的战略归属感与凝聚力。

二、保持研发投入，培育创新土壤

公司持续加大在集成电路先进封装测试等领域的研发力度，2025年度公司营业收入稳步增长、创出同期新高，当年研发投入同比增长31.63%达到11,768.82万元，首次超过1亿元，研发投入总额占营业收入比例为6.60%。在营业收入持续增长的情况下，最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过6%。晶圆减薄化表面应力提升技术研发、复合型铜镍金凸块工艺研发等多个项目导入量产，车规级高端芯片激光标识系统的研究等项目进入样品试制阶段。知识产权方面，报告期内，公司新获发明专利4项、实用新型专利51项。

2026年，公司将保持现有研发投入强度，一方面巩固凸块制造等现有核心技术领先优势，另一方面不断拓宽技术边界，紧跟人工智能时代市场需求，积极布局前沿先进封装技术。针对公司现有核心技术不断加强工艺研发，深挖先进封装护城河，保障制造稳定性，减少生产异常，提高产品良率，降低生产成

本。

三、完善公司治理，强化合规意识

报告期内，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

公司持续优化内部监督治理架构。2025年11月，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司取消了监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，构建权责清晰、协同高效的监督体系，全面提升公司治理监督效能。

2026年，公司将紧密围绕监管机构、上海证券交易所关于上市公司治理的最新法规要求，严格遵循公司治理相关制度规则规范开展治理工作，依法合规规范公司经营管理各项行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益。此外，公司将重点强化对“关键少数”的履职要求，目前已经制订了《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，将进一步明晰其责任担当；同时持续组织董事、高级管理人员参与监管部门、证券交易所等机构举办的专题培训，不断增强合规运作意识，切实提升履职能力。内部控制体系建设方面，公司将以港股上市为契机，聘请内控顾问全面梳理和优化公司内部控制与风险管理体系，严格对标港股上市监管标准，适配境内外A+H双重监管要求，加强关联方和关联交易管理，保证公司资产、人员、

财务、机构、业务等方面独立性，确保内控体系符合境内外双重监管要求，为合规经营提供坚实保障。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证E互动、分析师会议及业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。2025年，公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，在业绩发布和重大事项关键时点，通过投资者线上交流活动与中小投资者和机构投资者保持常态化沟通。2026年，公司将继续定期召开业绩说明会，保障全年业绩说明会召开次数不低于3次，及时向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，让投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况、发展现状等，增强投资者对公司的信心，努力夯实资本市场高质量发展基础。

五、践行股东回报，创造长期价值

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得

感，是上市公司发展的应有之义。公司牢固树立回报股东的意识，坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，重视投资者回报。

2025年5月16日，公司按照股东大会审议通过的利润分配方案完成权益分派实施工作，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），以总股本837,982,631股扣减回购专用证券账户中股份总数1,191万股后可参与利润分配的股份数为826,072,631股，以此为基数计算实际派发现金红利78,476,915.09元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.12%，较好的兼顾了投资者回报和公司发展资金留存需求。

公司经第二届董事会第十七次会议审议通过的2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年3月18日，公司总股本897,840,630股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利44,892,031.50元（含税）。最近三个会计年度累计现金分红总额达205,809,574.29元，最近三个会计年度累计现金分红占最近三个会计年度平均净利润的比例达120.95%。公司上市三年多以来持续高比例现金分红，在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力的前提下，兼顾投资者回报和公司发展、提升广大投资者的获得感，保障股东共享公司发展成果。

六、强化激励约束机制，共享发展成果

2025年，公司持续优化人才激励机制，稳步推进员工持股

计划落地实施，2023年限制性股票归属工作按计划完成，不仅稳定了核心人才团队，更充分调动了员工的积极性与创造力，进一步增强了公司核心竞争力，为企业长远发展注入强劲动力。

2026年，公司将进一步搭建并完善长效激励机制，精准吸引并留住优秀人才，充分激发核心团队的主观能动性，有效绑定股东、公司与核心团队的个人利益，促使各方凝心聚力，共同助力公司实现长远战略发展目标。

七、持续关注方案执行情况，维护公司市场形象

2025年，公司严格落实已制定的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，各项工作推进有序并取得阶段性进展与成效。2026年，公司将稳步推进本方案的落地执行，同时严格依法履行信息披露义务。未来，公司将持续提升经营管理精细化水平，深耕先进封装赛道，不断强化核心竞争力，稳步提升公司市场价值，切实回馈广大投资者的信任与支持，维护公司良好的市场形象，助力资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月19日